

深圳丹邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职深 SJ[2013]79-1 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3

前次募集资金使用情况鉴证报告

天职深 SJ[2013]79-1 号

深圳丹邦科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“丹邦科技公司”）截至2012年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

丹邦科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供丹邦科技公司定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为丹邦科技公司定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，丹邦科技公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映了丹邦科技公司截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况。

中国·北京

二〇一三年三月六日

中国注册会计师：黎明

中国注册会计师：黄琼

深圳丹邦科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2012年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1373号”文核准，深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.00元，募集资金总额为人民币52,000.00万元，扣除发行费用人民币2,410.73万元，实际募集资金净额为人民币49,589.27万元。于2011年9月13日存入本公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具了天健验[2011]3-55号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2012年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	2012年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	4000093229100007218	495,892,700.00	381,243.91	
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200059002618	0.00	111,526.06	
中国工商银行股份有限公司深圳侨城西街支行	4000093229100009270	0.00	8,385.25	账户名称：广东丹邦科技有限公司

二、前次募集资金使用情况说明

截至2012年12月31日止，本公司前次募集资金人民币49,589.27万元已全部使用完毕，募集资金实际投资项目与募集前承诺投资项目一致，不存在变更用途使用募集资金情况，截至2012年12月31日止，上述帐户余额为募集资金存放期间的利息。具体情况见下表：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳丹邦科技股份有限公司

截至 2012 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额：49,589.27						已累计使用募集资金总额：49,678.15				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2011 年：22,562.99				
						2012 年：27,115.16				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	42,500.00	42,500.00	42,584.64	42,500.00	42,500.00	42,584.64	84.64	2013 年 6 月 30 日
2	柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	---	7,089.27	7,093.51	---	7,089.27	7,093.51	4.24	2013 年 6 月 30 日
	合计		42,500.00	49,589.27	49,678.15	42,500.00	49,589.27	49,678.15	88.88	

说明：

1、根据天职国际会计师事务所有限公司于 2011 年 10 月 19 日出具的《关于深圳丹邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职深 QJ[2011]713 号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 200,720,747.31 元，明细如下：

序号	项目名称	已预先投入资金（元）
1	基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	200,720,747.31
	<u>合计</u>	<u>200,720,747.31</u>

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到 2011 年 9 月 30 日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 20,072.07 万元。

2、公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及自筹资金投资建设“柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目”的议案》（该议案已于 2012 年 1 月 5 日经公司 2012 年第一次临时股东大会批准），公司决定使用超募资金 7,089.27 万元投资建设柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目。

3、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金存在银行账户产生的利息投入募投项目所致。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司募集资金投资项目及超募资金投资项目尚未达到预定可使用状态，未产生效益。

四、其他差异说明

公司募集资金投资项目按照公司在首次公开发行并上市时相关文件中所披露的投资进度及建设周期，应于 2013 年下半年达到预定可使用状态。超募资金投资项目原定于 2013 年上半年达到预定可使用状态。

由于投资及建设进程加快，在 2011 年年度报告及 2012 年半年度报告披露时点，公司预计募集资金投资项目及超募资金投资项目达到预定可使用状态的时间将有所提前，分别提前至 2012 年 12 月 30 日及 11 月 30 日。

截至 2012 年 12 月 30 日，上述投资项目中部分生产设备仍处于安装、调试阶段，部分生产人员正在招聘、培训过程中，同时公司尚在办理相关验收手续，故上述投资项目尚未达到预定可使用状态，与已披露的 2011 年年度报告、2012 年半年度报告存在差异，具体情况见下表：

序号	投资项目		2011年年度报告及2012年半年报披露的项目达到预定可使用状态日期	项目达到预定可使用状态日期
	承诺投资项目	实际投资项目		
1	基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目	2012年12月30日	2013年6月30日
2	柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	柔性封装基板材料及工艺技术与产业化项目	2012年11月30日	2013年6月30日

五、与募集资金使用相关的其他情况说明

公司前次募集资金的使用按照前次募集说明书及其他相关信息披露文件中所承诺的投资项目实施，不存在将募集资金挪作他用的情况。公司履行的相关信息披露义务，符合法律法规及中国证券监督管理委员会的有关规定。

深圳丹邦科技股份有限公司

二〇一三年三月六日